Market News

„Driving decarbonization and digitalization. Together.“: Auf dem MWC 2023 zeigt Infineon die neuesten Halbleitertechnologien, mit denen das IoT komfortabler und umweltfreundlicher wird

München – 17. Februar 2023 – Mit dem Internet der Dinge (IoT) können viele Herausforderungen bewältigt werden, denen die Gesellschaft heute gegenübersteht. Mehr noch, sie verbessern die Lebensqualität, erleichtern den Alltag und erhöhen die Produktivität der Industrie. Das Herzstück jeder IoT-Lösung sind mikroelektronische Komponenten wie Sensoren, Aktoren, Mikrocontroller, Konnektivitätsmodule und Sicherheitskomponenten. Alle diese Bauteile sowie verschiedene Dienstleistungen, Softwares und Tools stellt die Infineon Technologies AG auf dem Mobile World Congress 2023 in Barcelona vom 27. Februar bis 2. März vor. Als ein führender Halbleiterhersteller für Power-Systems und IoT-Lösungen arbeitet Infineon gemeinsam mit Kunden und Partnern daran, die Dekarbonisierung und Digitalisierung voranzutreiben.

Unter dem Motto „Driving decarbonization and digitalization. Together.“ freut sich Infineon darauf, seine Kunden in diesem Jahr wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Darüber hinaus können sich Kunden für die digitale Plattform von Infineon registrieren – der perfekte Ort, um während und nach der Veranstaltung tiefer in die verschiedenen Technologien einzutauchen, die auf dem MWC präsentiert werden. Der Infineon-Stand in Halle 5a (Stand 51) umfasst mehrere Schwerpunktbereiche:

- **Intelligente Halbleiterlösungen ermöglichen ein gesundes Leben**
  Die Halbleiterprodukte von Infineon passen perfekte zu Smart-Health-Geräten, da sie die Anforderungen von digitalen Gesundheitsgeräten erfüllen. Sie unterstützen einen gesundheitsbewussten Lebensstil, indem sie Smart-Home-Geräte ermöglichen, die zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen können. So können beispielsweise intelligente Lautsprecher mit Radarsensoren einen Herzschlag erkennen. Sie erkennen auch, ob jemand zu Boden gestürzt ist, hustet oder schnarcht. So ermöglichen die Lösungen von Infineon ein komfortableres, aber auch ein längeres, unabhängigeres und gesünderes Leben zu Hause – und das in einer zunehmend alternden Gesellschaft.

Public / Für die Fachpresse
Informationsnummer INFXX202302.061d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
Tel.: +49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

- **AR für Unternehmen und medizinische Einrichtungen**
  Magic Leap 2, das neueste AR-Gerät des AR-Pioniers Magic Leap, wurde eigens für den Einsatz in Unternehmen und im Gesundheitswesen entwickelt. Eines der wichtigsten Merkmale der neuesten Magic-Leap-Generation ist die 3D-Tiefensensortechnologie mit indirektem Licht-ToF (iToF), die gemeinsam von Infineon und pmdtechnologies entwickelt wurde. Die neue und verbesserte iToF-Technologie verknüpft die reale und die digitale Welt durch eine verbesserte Gestensteuerung und präzisere Anwenderinteraktion. Dadurch eröffnen sich neue Anwendungen, bei denen Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend sind, wie etwa bei der Fernwartung und -diagnose von Industriemaschinen oder bei der KI-gestützten Chirurgie, die es Ärzten ermöglicht, die Anatomie ihrer Patienten besser zu verstehen.

- **Dekarbonisierung von Rechenzentren für eine grünere Zukunft**
  In Smart Homes und anderen Bereichen steigt die Zahl der vernetzten Geräte. Daher müssen bis 2025 weltweit schätzungsweise 175 Zettabyte an Daten verarbeitet werden. Damit steigt auch der Energiebedarf der weltweit rund 8.000 Rechenzentren drastisch an, insbesondere für die Kühlung der Server. Auf dem MWC 23 demonstriert Infineon gemeinsam mit Super Micro Computer, wie umweltfreundliche Computing-Plattformen einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Computertechnik leisten können. Die MicroBlade®-Familie bietet eine erstklassige Serverdichte für eine Vielzahl von Prozessoren und verfügt über integrierte OptiMOS™-Leistungsstufen mit höchster Effizienz.

- **„Dinge“ werden zu Zahlungsgeräten**
  Warum sollte man nur mit seiner Kreditkarte, seinem Smartphone oder seiner Smartwatch bezahlen? Die Technologie von Infineon trägt zur Digitalisierung des Zahlungsverkehrs bei, indem sie praktisch alles von Smartwatches und Fitness-Trackern bis hin zu Ringen, Armbändern und mehr in ein Zahlungsgerät verwandelt. Möglich wird das mit einem Chip, der nur halb so groß ist wie ein Marienkäfer. Auf dem MWC 23 zeigt Infineon, wie ein extrem niedriger Energiebedarf und winzige Formfaktoren den Weg für eine ganz neue Dimension von NFC-fähigen Wearables ebnen, die schnelles, bequemes und sicheres Bezahlen ermöglichen. Diese werden so den immer anspruchsvolleren Sicherheits- und Kontaktlos-Anforderungen der Zahlungsindustrie gerecht.

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
Tel.: +49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

Infineon und adidas präsentieren smarte und interaktive Jacke

Auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona lädt Infineon die adidas AG ein, den Prototyp einer interaktiven, intelligenten Jacke am Infineon-Stand zu präsentieren. Die „5G Connected Sport Jacket“ der adidas AG ermöglicht zu jeder Zeit und an jedem Ort Echtzeit-Feedback zu Fitnessdaten, Konnektivität sowie ein SOS-Alarmsystem für Notfälle. Solche Anwendungen, die in Kleidung oder in beliebige tragbare Geräte eingebettet sind, beruhen auf Halbleitertechnologien, die sogar eine Jacke in ein intelligentes Gerät verwandeln. So müssen beim Sport keine anderen mobilen Geräte verwendet werden.

Infineon auf dem Mobile World Congress 2023

Der Mobile World Congress 2023 findet vom 27. Februar bis 2. März 2023 in Barcelona, Spanien, statt. Unter dem Motto „Driving decarbonization and digitalization. Together.“ zeigt Infineon in Halle 5a am Stand 51 und virtuell, wie die neuesten Halbleitertechnologien Smart Homes, Smart Factories und kabellose Infrastrukturen verändern. Informationen zu den Show Highlights des MWC sind erhältlich unter www.infineon.com/mwc.

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
Tel.: +49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:

Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Reinhard von Faltin
Tel.: +49 89 234 39694
reinhard.vonfaltin@infineon.com

Investor Relations:

Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com